

# 積層メモリー向けチラー開発

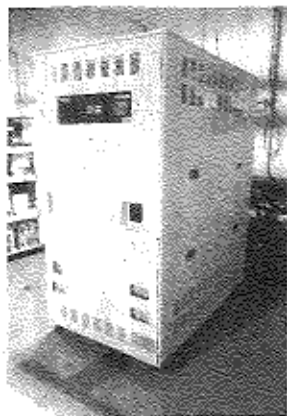
## エイディーディー

機械・ロボット・航空機

### 工場新設、9月めど投入

### 半導体メーカーに提案

【静岡】エイディーディー（静岡県沼津市、下田一専社長、055・943・6371）は、次世代の3次元実装と期待されるシリコン貫通電極（TSV）積層メモリー向けの超低温冷却水循環装置（チラー）を開発した。9月をめどに本格的に発売する。約1000度Cに冷却でき、冷却能力は4 $\text{P}_{\text{e}}$ 。価格は1800万円（消費税抜き）。半導体メーカーなどに提案し、2020年に月産10台の販売を見込む。21年稼働を目指し、本社第3工場（沼津市）を新設し、供給力を高める。



TSV積層メモリー向けの超低温チラー装置を半導体メーカーなどに提案

開発した新型機の1号機を韓国の大手半導体メーカーの日本法人に納入した。チラーはエイディーディー独自の超低温技術である冷媒に蒸発温度の違う3種類のフロンを混ぜる。熱交換器内部で液化和気化を繰り返す構造を基本とし、さらに

工夫を加えた。

TSVは半導体を3次元積層して高性能化を図る技術。チップの表面と裏面を貫通する電極を作ること、半導体LSIの高集積化を促す技術と期待されている。製造工程のうち、エッチング深掘りでは、より多層化した場合の高精度加工を実現するため、超低温での冷却が必要となっている。

エイディーディーはチラーの修理を軸に、チラー、成膜装置など

ほフル操業状態にある。そのため隣接地に土地を購入し、建物面積約900平方メートルのチラー・フリーザーの組立工場を建設する考え。投資額は約3億円を見込む。

主力のチラー修理は売上高の60%を占める。旺盛な需要を背景に、21年5月期に19年5月期見込み比約4・6倍の売上高30億円を目指す。